

2006年8月2日
株式会社 日立製作所
株式会社 アキタ電子システムズ

日立の半導体後工程実装事業をエルピーダメモリに譲渡
アキタ電子システムズおよびアキタセミコンダクタの半導体後工程実装事業を
エルピーダメモリの子会社に売却

株式会社 日立製作所(執行役社長:古川 一夫/コード番号:6501/以下、日立)は、このたび、2006年10月1日付にて、日立の半導体後工程実装事業をエルピーダメモリ株式会社(代表取締役社長兼 CEO:坂本 幸雄/コード番号:6665/以下、エルピーダメモリ)に譲渡することで、同社と合意をいたしました。

今回の合意により、日立は、グループ会社の株式会社 アキタ電子システムズ(取締役社長:西村 光太郎)およびその子会社である株式会社 アキタセミコンダクタ(取締役社長:田中 光助)における半導体後工程実装事業を、エルピーダメモリがあらたに設立する秋田エルピーダメモリ株式会社(代表取締役社長:渡辺 敬行/以下、秋田エルピーダ)に売却します。

日立は、半導体事業において、DRAM 事業をエルピーダメモリに、また、2003年にはシステム LSI などの事業を三菱電機株式会社とともに設立した株式会社ルネサス テクノロジーに移管するなど、さまざまな事業再編に取り組んできました。

今回、譲渡の対象となるアキタ電子システムズ、アキタセミコンダクタの半導体後工程実装事業は、これまで、おもに先端パッケージ加工受託やエルピーダメモリ向けのテストビジネスを行ってきました。そして、このたび、エルピーダメモリより、携帯電話やデジタルコンシューマ分野などのハイエンドデバイスに対応した高密度実装技術の確立、ならびに効率的な開発・生産体制の構築を目的に、事業を譲り受けたい旨の申し入れがあり、一方で、日立としても、長年にわたって培ってきたノウハウや技術、資産を最大限に生かすためには、同社との一体運営が最適と考え、今回の合意に至りました。

これにより、現在、アキタ電子システムズ、アキタセミコンダクタにて当該事業に携わっている社員は、秋田エルピーダに転籍となる予定です。さらに、エルピーダメモリ以外の顧客向けのパッケージ加工受託ビジネスについても、秋田エルピーダにて継続していくこととなります。

なお、アキタ電子システムズおよびアキタセミコンダクタは、半導体後工程実装事業の譲渡後、2007年4月1日付にて合併する予定です。新会社では、両社が取り組んできた半導体後工程実装以外のソフトウェア開発・販売、LSI 開発・設計受託などについて、事業を継続していきます。

<アキタ電子システムズの概要>

- (1)社 名:株式会社 アキタ電子システムズ
- (2)本社所在地:秋田県秋田市雄和相川字後野 85 番地
- (3)代 表 者:取締役社長 西村 光太郎
- (4)設 立 :2002 年 4 月(前身のアキタ電子株式会社の設立は 1969 年 4 月)
- (5)資 本 金:480 百万円(日立 100%出資)
- (6)売 上 高:194 億円(連結ベース、2005 年度実績)
- (7)従 業 員 数:299 名(2006 年 4 月末現在)
- (8)事 業 内 容: LSI、SLP(*)の開発、設計および製造、販売、 ソフトウェアの開発、販売
(*)SLP(System Level Product):小さな基板上に、電子部品を搭載したモジュール

<アキタセミコンダクタの概要>

- (1)社 名:株式会社 アキタセミコンダクタ
- (2)本社所在地:秋田県秋田市雄和石田字山田 89 番地
- (3)代 表 者:取締役社長 田中 光助
- (4)設 立 :2002 年 4 月
- (5)資 本 金:50 百万円(アキタ電子システムズ 100%出資)
- (6)売 上 高:154 億円(2005 年度実績)
- (7)従 業 員 数:196 名(2006 年 4 月末現在)
- (8)事 業 内 容:LSI、SLP の製造

以 上

このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
